证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 股票上市地点：上海证券交易所

上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买报告书(草案)摘要

交易对方	住所
瑞滇投资管理有限公司	云南省昆明市高新区海源北路六号招商大厦

独立财务顾问

国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. 中德证券有限责任公司 Zhong De Securities Co., Ltd.

二〇一八年十一月

声 明

一、公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。

二、交易对方声明

本次重大资产重组的交易对方瑞滇投资承诺：

1、对所持标的公司股权拥有合法的、完整的所有权和处分权，在股东主体资格方面不存在任何瑕疵或异议的情形，不存在任何形式的委托持股、信托持股或者类似安排，不存在产权纠纷或潜在纠纷；已足额缴付所持标的公司股权对应的注册资本，不存在任何虚假出资、迟延出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为；所持标的公司股权不存在质押、查封、冻结、权属争议及其他权利限制，不存在可能影响标的公司合法存续的情况，并承诺前述情况保持至本次交易实施完毕前；承诺方所持标的公司股权过户或权属转移至韦尔股份名下不存在法律障碍。

2、承诺方将及时向韦尔股份提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，所描述的事实有充分、客观、公正的依据，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，向韦尔股份及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给韦尔股份或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。

3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺方不转让在韦尔股份拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交韦尔股份董事会，由董事会代本机构向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

三、相关证券服务机构声明

本次重大资产重组的证券服务机构及相关经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。本次重大资产重组的证券服务机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的将承担连带赔偿责任。

释 义

公司/本公司/韦尔股份/上市公司	指	上海韦尔半导体股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码为603501
交易对方/瑞滇投资	指	瑞滇投资管理有限公司
标的公司	指	深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司
芯能投资	指	深圳市芯能投资有限公司
芯力投资	指	深圳市芯力投资有限公司
北京豪威/豪威科技	指	北京豪威科技有限公司
本次交易/本次重组/本次重大资产重组/	指	韦尔股份现金购买芯能投资、芯力投资各 100%股权
标的资产/交易标的/拟购买资产	指	芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权
云南城投	指	云南省城市建设投资集团有限公司(曾用名“云南省城市建设投资有限公司)
云交所	指	云南产权交易所有限公司
本次重大资产购买	指	韦尔股份拟以现金购买瑞滇投资持有的芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权的行为
本报告书/重组报告书/重大资产购买报告书	指	上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买报告书(草案)摘要
绍兴韦豪	指	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)
青岛融通	指	青岛融通民和投资中心(有限合伙)
Seagull(A3)	指	Seagull Strategic Investments(A3),LLC
嘉兴水木	指	嘉兴水木豪威股权投资合伙企业(有限合伙)
嘉兴豪威	指	嘉兴豪威股权投资合伙企业(有限合伙)
上海唐芯	指	上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙)
海鸥开曼	指	Seagull Holdings Cayman Limited
海鸥香港	指	Seagull Holdings Hong Kong Limited
Seagull Investments	指	Seagull Investments, LLC
金石暴风	指	青岛金石暴风投资咨询有限公司
珠海融锋	指	珠海融锋股权投资合伙企业(有限合伙)
润信豪泰	指	北京润信豪泰投资中心(有限合伙)
西藏长乐	指	西藏长乐投资有限公司
泰康保险	指	泰康保险集团股份有限公司
泰康人寿	指	泰康人寿保险有限责任公司
创意传奇	指	Creative Legend Investments Ltd.
奥视嘉创	指	深圳市奥视嘉创股权投资合伙企业(有限合伙)
深圳测度	指	深圳市测度通信技术有限公司
清控华科	指	清控华科(天津)投资中心(有限合伙)
首誉光控	指	首誉光控资产管理有限公司
开元朱雀	指	开元朱雀(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)
元禾华创	指	合肥元禾华创中合股权投资合伙企业(有限合伙)
北京集电	指	北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)
天元滨海	指	北京天元滨海股权投资基金合伙企业(有限合伙)
惠盈一号	指	深圳惠盈一号投资合伙企业(有限合伙)
领智基石	指	马鞍山领智基石股权投资合伙企业(有限合伙)
金信华创	指	北京金信华创股权投资中心(有限合伙)
金信华通	指	南通金信华通股权投资中心(有限合伙)
西藏大数	指	西藏大数和泰实业有限公司
上海威熠	指	上海威熠企业管理咨询有限公司
西藏锦祥	指	西藏锦祥投资有限公司
上海摩勤	指	上海摩勤智能技术有限公司
Seagull(A1)	指	Seagull Strategic Investments(A1), LLC
Seagull(C1-Int'l)	指	Seagull Equity Investments(C1-Int'l)(Hong Kong)Limited
Seagull(C3-Int'l)	指	Seagull Equity Investments (C3-Int'l) (Hong Kong) Limited
Seagull(C1)	指	Seagull Equity Investments(C1),LLC
Seagull(C3)	指	Seagull Equity Investments (C3), LLC
Seagull(B1)	指	Seagull Equity Investments (B1) (Cayman), LLC
Seagull(B2)	指	Seagull Equity Investments (B-2) (Hong Kong) Limited
德威资本	指	深圳德威资本投资管理有限公司
深圳远卓	指	深圳市远卓财富投资企业(有限合伙)
深圳兴平	指	深圳市兴平股权投资管理企业(有限合伙)
上海清恩	指	上海清恩资产管理合伙企业(有限合伙)
香港韦尔	指	韦尔半导体香港有限公司，上市公司子公司
美国豪威	指	OmniVision Technologies, Inc.
豪威国际控股	指	OmniVision International Holding Ltd
豪威半导体	指	豪威半导体(上海)有限责任公司
豪威科技(上海)	指	豪威科技(上海)有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/证券交易所	指	上海证券交易所
中登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
独立财务顾问	指	国信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
中德证券	指	中德证券有限责任公司
立信会计师	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道	指	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
律师/法律顾问/天元律师	指	北京市天元律师事务所
评估机构/立信评估	指	上海立信资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《26 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
《重组若干规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《公司章程》	指	《上海韦尔半导体股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《暂行规定》	指	《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
报告期/最近两年及一期	指	2016 年、2017 年和 2018 年 1-7 月
最近一年及一期	指	2017 年和 2018 年 1-7 月
报告期各期末	指	2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 7 月 31 日
评估基准日	指	2018 年 7 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
美元	指	美国美元，美国货币单位
半导体产品	指	广义的半导体、电子元器件产品，包括集成电路芯片和其他电子元器件产品
半导体分销业务	指	广义的半导体、电子元器件分销业务，包括集成电路芯片和其他电子元器件分销业务
IC	指	Integrated Circuit 即集成电路，是采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路
TVS	指	Transient Voltage Suppresser，即瞬态电压抑制器，是普遍使用的一种新型高效电路保护器件。它具有极快的响应时间（亚纳秒级）和相当高的浪涌吸收能力，可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压，以及感应雷所产生的过电压
CMOS	指	Complementary Metal-Oxide-Semiconductor 的简写，即互补型金属氧化物半导体，是一种电压控制的半导体放大器件，是大规模集成电路的基础单元
CP 测试	指	Chip Prober 测试，即 IC 在后工序之前都必须进行的测试程序，以验证产品的功能是否正常，挑出不良的产品，并区分性能等级
EMS	指	Electronic Manufacturer Service 或称 Electronic Contract Manufacturing，中文又译为专业电子代工服务，或电子专业制造服务，是为电子产品品牌拥有者提供制造、采购、部分设计以及物流等一系列服务的生产厂商
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，贴牌生产合作模式，俗称“贴牌生产”。指企业利用自己掌握的品牌优势、核心技术和销售渠道，将产品委托给具备生产能力的制造商生产后向市场销售。品牌拥有者（委托方）一般自行负责设计和开发新产品，有时也与制造商（受委托方）共同设计研发，但品牌拥有者控制销售渠道
ODM	指	Original Design Manufacture，原始设计制造商。它可以为客户提供从产品研发、设计制造到后期维护的全部服务，客户只需向 ODM 服务商提出产品的功能、性能甚至只需提供产品的构思，ODM 服务商就可以将产品从设想变为现实
IDM	指	Integrated Device Manufacturer，垂直整合制造商，代表垂直整合制造模式，指业务范围涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等全业务环节的集成电路企业组织模式
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路设计企业，与 IDM 相比，指仅仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工、封装测试厂商的模式
FAE	指	Field Application Engineer，现场技术支持工程师，也叫售前售后服务工程师。售前对客户进行产品的技术引导和技术培训、为客户进行方案设计以及给公司销售人员提供技术支持；售后对客户进行产品的售后技术服务、市场引导并将市场信息反馈给研发人员
CCD	指	Charge Coupled Device，电荷耦合元件
CameraCubeChip	指	一种采用先进的芯片级封装技术整合集成晶圆级光学器件和 CMOS 图像传感器创新的解决方案
LCOS	指	Liquid Crystal on Silicon，即液晶附硅，也叫硅基液晶，是一种基于反射模式，尺寸非常小的矩阵液晶显示装置
BSI	指	Backside Illumination，背面照射技术

本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

重大事项提示

本公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案概述

2018 年 11 月 28 日，云交所确认韦尔股份为本次瑞滇投资挂牌转让资产芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权的受让方。芯能投资、芯力投资均为专门投资北京豪威设立的投资实体，合计持有北京豪威 10.5464%的股权。

本次重大资产购买，上市公司将以现金购买瑞滇投资持有的芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权。

二、标的资产评估值及交易作价

根据立信评估分别出具的《上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买所涉及的深圳市芯能投资有限公司股东全部权益资产评估报告》(信资评报字(2018)第 40136-30 号)、《上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买所涉及的深圳市芯力投资有限公司股东全部权益资产评估报告》(信资评报字(2018)第 40136-29 号)，截至评估基准日 2018 年 7 月 31 日，芯能投资净资产账面值为 54,431.50 万元，芯能投资股东全部权益评估值为 89,130.52 万元，增值 34,699.02 万元，增值率 63.75%；芯力投资净资产账面值为 36,814.20 万元，芯力投资股东全部权益评估值为 59,900.12 万元，增值 23,085.92 万元，增值率 62.71%。

根据瑞滇投资在云交所的挂牌底价，芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权挂牌底价合计 168,741.925 万元，上市公司竞买摘牌及本次交易的成交价格为 168,741.925 万元，具体如下：

交易对方	标的公司	交易价格(万元)
瑞滇投资	芯能投资 100%股权	100,919.189
	芯力投资 100%股权	67,822.736
合计		168,741.925

三、本次重组的对价支付方式

本次交易对价的支付方式为现金。资金来源为自筹资金，包括上市公司自有资金、银行借款或其他合法渠道及方式筹集的资金。

经交易各方同意，本次交易对价在《产权交易合同》所约定的交割的前提条件满足后分两期支付，具体支付安排如下：

支付比例	支付金额(万元)	支付时间及条件
第一期:全部转让款的 30%	50,622.5775	韦尔股份于《产权交易合同》生效之日后 5 个工作日内支付
第二期:全部转让款的 70%	118,119.3475	韦尔股份于《产权交易合同》生效之日起 30 个工作日内付清

四、本次交易构成重大资产重组

《重组管理办法》第十四条规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

根据上述规定，将本次重大资产购买前 12 个月韦尔股份（含韦尔股份全资子公司）现金购买北京豪威 1.9543%和 1.97%股权与本次交易标的资产合并计算，相关财务比例计算如下：

单位：万元

项目	资产总额	营业收入	资产净额
芯能投资 100%股权	54,431.60	—	54,431.50
芯力投资 100%股权	36,814.30	—	36,814.20
北京豪威 3.9243%股权	54,977.16	35,516.31	54,977.16
上述资产合计	146,223.06	35,516.31	146,222.86
成交金额	223,719.09	—	223,719.09
韦尔股份	282,490.82	240,591.63	117,976.44
财务指标占比	79.20%	14.76%	189.63%

注 1：2018 年 7 月和 8 月，韦尔股份分别收购了北京豪威 1.9543%和 1.97%股权，合计 3.9243%，成交金额合计 54,977.16 万元。

注 2：成交金额=芯能投资、芯力投资 100%股权成交价+北京豪威 3.9243%股权成交价。

根据上表，标的资产成交金额以及 12 个月内连续对同一或者相关资产交易金额占上市公司 2017 年经审计合并资产总额、资产净额的比例超过 50%，因此本次交易构成重大资产重组。

五、本次交易不构成重组上市

本次交易前，虞仁荣持有韦尔股份 279,435,000 股股份，占上市公司总股本的 61.30%，为上市公司控股股东、实际控制人。由于本次交易为现金收购，不涉及发行股份，故本次交易后公司控股股东、实际控制人仍为虞仁荣，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，亦不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

六、本次交易不构成关联交易

根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方与上市公司不存在关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。

七、本次交易对上市公司的影响

(一)对上市公司股权结构的影响

本次交易为现金收购，不涉及股份发行，不会导致上市公司股权结构发生变化。

(二)对上市公司业务的影响

本次交易前，韦尔股份主营半导体设计及分销业务，其中设计业务的主要产品包括分立器件（TVS、MOSFET 等）、电源管理 IC、射频芯片、卫星接收芯片等。分销业务主要代理及销售数十家国内外著名半导体生产厂商的产品，与设计业务相互补充，以满足终端客户多样化的产品市场需求。

本次交易标的公司芯能投资、芯力投资是专为投资北京豪威设立的实体，北京豪威为芯片设计公司，主营业务为 CMOS 图像传感器的研发和销售，韦尔股份与北京豪威的客户均主要集中在移动通信、平板电脑、安防、汽车电子等领域，终端客户重合度较高。通过本次交易，一方面丰富了上市公司设计业务产品类别，带动公司半导体设计整体技术水平快速提升，另一方面也为公司带来智能手机、安防、汽车、医疗等领域优质的客户资源。此外，借助韦尔股份的分销渠道优势，能够快速获取更全面的市场信息，北京豪威可以将精力集中于客户设计方案的理解和芯片产品研发上，进而使得公司整体方案解决能力得到加强，为客户提供更好的解决方案及专业化指导。

因此，本次交易符合上市公司未来发展战略布局。

(三)对上市公司主要财务数据的影响

根据上市公司财务报表与立信会计师出具的《备考审阅报告》(信会师报字[2018]第 ZA15939 号)，本次交易前后，上市公司主要财务数据对比如下：

单位：万元

项目	2018.7.31/2018 年 1-7 月		变动额	变动比率
	实际数据	备考数据		
资产合计	368,462.67	537,204.80	168,742.13	45.80%
负债合计	214,356.72	354,943.81	140,587.09	65.59%
所有者权益合计	154,105.96	182,260.99	28,155.03	18.27%
归属于母公司股东权益合计	153,122.94	181,277.97	28,155.03	18.39%
营业收入	230,787.33	230,787.33	0.00	0.00%
归属于母公司股东的净利润	19,241.33	19,699.29	457.96	2.38%
项目	2017.12.31/2017 年		变动额	变动比率
	实际数据	备考数据		
资产合计	282,490.82	446,958.19	164,467.37	58.22%
负债合计	163,426.73	304,013.63	140,586.90	86.02%
所有者权益合计	119,064.09	142,944.56	23,880.47	20.06%
归属于母公司股东权益合计	117,976.44	141,856.92	23,880.48	20.24%
营业收入	240,591.63	240,591.63	0.00	0.00%
归属于母公司股东的净利润	13,715.63	42,374.84	28,659.21	208.95%

八、本次交易已履行和尚需履行的批准程序

(一)本次交易已履行的批准程序

1、上市公司的决策过程

2018 年 10 月 25 日，韦尔股份第四届董事会第三十一次会议审议通过参与竞买芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权的议案。

2018 年 11 月 12 日，韦尔股份 2018 年第三次临时股东大会审议通过参与竞买芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权的议案。

2018 年 11 月 14 日，韦尔股份第四届董事会第三十二次会议审议通过本次重大资产购买预案等议案。

2018 年 12 月 4 日，韦尔股份第四届董事会第三十四次会议审议通过本次重大资产购买方案等议案。

2、标的公司的决策过程

芯能投资、芯力投资股东瑞滇投资已作出股东决定，同意通过产权交易所公开出让其持有的芯能投资、芯力投资各 100%股权。

3、交易对方的决策过程

瑞滇投资股东云南城投董事会已作出决议，同意瑞滇投资通过产权交易所公开出让所持芯能投资、芯力投资各 100%股权。

(二)本次交易尚需获得的授权、批准和核准

本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：

1、上市公司召开股东大会批准本次交易；

2、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

本次交易能否获得上述相关审批、同意，以及获得审批、同意的时间，均存在不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。

本次交易不属于《重组管理办法》第十三条的情形，不涉及发行股份，无需按照《重组管理办法》第二十九条或第四十四条的规定提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审批。

九、本次交易相关方作出的重要承诺

(一)交易对方作出的重要承诺

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
关于本次交易相关事项的承诺函	瑞滇投资	1、关于标的公司股权的权属事项 (1)承诺方对所持标的公司股权拥有合法的、完整的所有权和处分权，在股东主体资格方面不存在任何瑕疵或异议的情形，不存在任何形式的委托持股、信托持股或者类似安排，不存在产权纠纷或潜在纠纷； (2)承诺方已足额缴付所持标的公司股权对应的注册资本，不存在任何虚假出资、迟延出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为； (3)承诺方所持标的公司股权不存在质押、查封、冻结、权属争议及其他权利限制，不存在可能影响标的公司合法存续的情况，并承诺前述情况保持至本次交易实施完毕前； (4)承诺方所持标的公司股权过户或权属转移至韦尔股份名下不存在法律障碍。 2、关于诉讼、仲裁及行政处罚事项 承诺方及主要管理人员最近五年内未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的任何重大民事诉讼或者仲裁；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。 3、关于不存在不得参与上市公司重大资产重组的事项 承诺方及其董事、监事、高级管理人员、承诺方的控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，均不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定不得参与上市公司重大资产重组的情形 5、关于内幕交易事项 承诺方及其控股股东、实际控制人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因本次交易相关事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形。 6、关于与韦尔股份不存在关联关系事项 承诺方不是韦尔股份的关联人（关联人的范围根据《上海证券交易所股票上市规则》确定），承诺方与韦尔股份不存在任何关联关系，承诺方不存在向韦尔股份推荐董事或者高级管理人员的情况。
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函	瑞滇投资	1、承诺方将及时向韦尔股份提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，所描述的事实有充分、客观、公正的依据，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，向韦尔股份及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给韦尔股份或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。 2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺方不转让在韦尔股份拥有权益的股份(如有)，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交韦尔股份董事会，由董事会代本机构向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

(二)标的公司及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
关于本次交易相关事项的承诺函	芯能投资、芯力投资	1、芯能投资/芯力投资为依法设立且合法有效存续的有限责任公司，截至目前，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》所规定的需要终止的情形，不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形，不存在影响其合法存续的情况。 2、芯能投资/芯力投资近三年在所有重大方面合法、合规，不存在重大违法、违规行为，未受到包括但不限于工商、海关、外汇、产品质量、安全生产、环境保护、税务、劳动与社会保障等部门的行政处罚；不存在对本次交易构成实质性障碍的正在进行或尚未了结的以及可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。 3、芯能投资/芯力投资作为一方当事人的合同均为依法成立，合同内容和要件完备，履行正常，属于公司正常经营范围，业务真实，不存在潜在的法律纠纷。 4、芯能投资/芯力投资的董事、监事、主要管理人员最近五年内不存在受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的尚未了结的对其资产状况、财务状况产生重大不利影响的重大民事诉讼或者仲裁的情形，不存在被证券监督管理部门立案调查、或被证券交易所公开谴责的情形或其他不良记录，亦不存在涉嫌有重大违法行为的情形。 5、芯能投资/芯力投资合法拥有、行使其主要财产的所有权或使用权，且该等财产权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制，不涉及重大诉讼、仲裁、司法强制执行等对本次交易构成实质性障碍的争议、纠纷；芯能投资/芯力投资不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，受到行政处罚或者刑事处罚的情况。 6、芯能投资/芯力投资及其董事、监事、高级管理人员均不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定不得参与上市公司重大资产重组的情形。 7、芯能投资/芯力投资将及时向韦尔股份提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，所描述的事实有充分、客观、公正的依据，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给韦尔股份或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。
关于本次交易相关事项的承诺函	芯能投资、芯力投资董事、监事、高级管理人员	1、承诺方将及时向韦尔股份提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，所描述的事实有充分、客观、公正的依据，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，向韦尔股份及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给韦尔股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 2、承诺方最近五年内不存在受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的尚未了结的对承诺方资产状况、财务状况产生重大不利影响的重大民事诉讼或者仲裁的情形，不存在被证券监督管理部门立案调查、或被证券交易所公开谴责的情形或其他不良记录，亦不存在涉嫌有重大违法行为的情形。 3、承诺方不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定不得参与上市公司重大资产重组的情形。

(三)上市公司及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
关于本次交易相关事项的承诺函	上市公司	1、本次交易提供的信息真实、准确、完整，所描述的事实有充分、客观、公正的依据，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、截至本承诺函出具之日，不存在本公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形。 3、截至本承诺函出具之日，不存在本公司及下属子公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。 4、截至本承诺函出具之日，本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形；本公司最近三年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚。 5、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控股股东、实际控制人最近十二个月内均不存在受到证券交易所公开谴责的情形，均不存在其他重大失信行为；本公司现任董事、高级管理人员均不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形；本公司现任董事、高级管理人员亦不存在最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。 6、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及上述主体控制的机构均不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
关于本次交易相关事项的承诺函	韦尔股份董事、监事、高级管理人员	承诺方及承诺方控制的机构不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函	韦尔股份董事、监事、高级管理人员	1、承诺方保证本次交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺方对本次交易申请文件内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺方不转让在韦尔股份拥有权益的股份(如有)，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交韦尔股份董事会，由董事会代承诺方向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺函	韦尔股份实际控制人	1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。 3、承诺对职务消费行为进行约束。 4、承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。 5、承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 7、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺方届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 8、承诺方承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对上市公司或者投资者的赔偿责任。
关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺函	韦尔股份董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。 2、承诺对职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺方届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 7、承诺方承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

十、相关方对本次重组的原则性意见及相关股份减持计划

(一)控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

韦尔股份控股股东虞仁荣已出具说明，原则性同意本次交易。

(二)控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

1、控股股东及其一致行动人的减持计划

上市公司控股股东虞仁荣出具如下说明：在韦尔股份本次重组报告书（草案）披露之日起至本次重组实施完毕期间，本人不存在减持韦尔股份股票的计划。若违反上述声明，由此给韦尔股份或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向韦尔股份或其他投资者依法承担赔偿责任。

上市公司控股股东之一致行动人虞小荣出具如下说明：根据《上海韦尔半导体股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》，韦尔股份于 2017 年 11 月 29 日向本人授予的限制性股票的 10%在符合解锁条件的情况下自授予日起 12 个月后的首个交易日起可办理解除限售手续。因个人资金需求，本人计划将在韦尔股份本次重组报告书(草案)披露之日起至本次重组实施完毕期间，减持韦尔股份不超过 147,200 股。本人承诺将严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、上交所相关规定实施股票减持，并及时履行信息披露义务。若违反上述声明，由此给韦尔股份或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向韦尔股份或其他投资者依法承担赔偿责任。

2、董事、监事、高级管理人员的减持计划

上市公司部分董事或高级管理人员马剑秋、纪刚、贾渊等三人出具如下说明：本人于韦尔股份首次公开发行股票并上市前取得的韦尔股份股票已于 2018 年 5 月 4 日解除限售。根据《上海韦尔半导体股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》，韦尔股份于 2017 年 11 月 29 日向本人授予的限制性股票的 10%在符合解锁条件的情况下自授予日起 12 个月后的首个交易日起可办理解除限售手续。因个人资金需求，本人计划将在韦尔股份本次重组报告书(草案)披露之日起至本次重组实施完毕期间，对韦尔股份进行减持，具体计划如下：

姓名	职务	持股数(股)	计划减持股份(股)
马剑秋	董事、总经理	7,798,000	3,411,625
纪刚	董事、副总经理	7,240,000	3,167,500
贾渊	董事、董事会秘书、财务总监	4,775,000	1,355,000

十一、对股东权益的保护安排

上市公司在本次交易的决策过程中，按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的精神和中国证监会《重组管理办法》的规定，采取了多项措施以保护中小投资者的权益，具体措施如下：

(一)及时、准确披露本次交易的相关信息

公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组管理办法》、《重组若干规定》等相关法律、法规的要求对本次交易方案采取严格的保密措施，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告书披露后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。

(二)严格履行相关程序

公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。本报告书在提交董事会讨论时，独立董事就该事项发表了独立意见。公司聘请的中介机构分别出具了独立财务顾问报告、法律意见书、审计报告、评估报告等。根据《重组管理办法》等有关规定，公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒股东参加审议本次交易方案的股东大会。

(三)提供网络投票平台

公司将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，在表决本次交易方案的股东大会中，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，充分保护中小股东行使股东权利。股东大会所作决议必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司对中小投资者投票情况单独统计并予以披露。

(四)确保本次交易定价公允、合理

公司在参与标的资产竞买前，严格履行了董事会、股东大会的批准程序。本次交易标的资产的交易价格以交易对方在云交所挂牌的底价来确定，上市公司聘请立信评估对标的资产出具了评估报告，考虑到标的资产与上市公司的协同效应，本次竞买价格合理，公司独立董事已对评估定价的公允性发表独立意见。

(五)严格遵守利润分配政策

公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾本公司的长远利益、全体股东的整体利益及本公司的可持续性发展。在公司经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应积极实施利润分配政策。本公司将按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。

本次交易完成后，本公司将按照《公司章程》的约定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合本公司实际情况、政策导向和市场意愿，不断提高运营绩效，完善股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。

(六)其他保护投资者权益的措施

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次重组过程中所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。本次交易完成后，公司将继续保持独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上遵循独立原则，遵守中国证监会有关规定，继续规范运作。

重大风险提示

投资者在评价本公司本次交易时，除本报告书的其他内容外，还应特别认真考虑下述各项风险因素。

一、与本次交易有关的风险

(一)本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

本公司已经按照相关规定制定了严格的内幕知情人登记管理制度，在与交易对方协商过程中严格控制内幕信息知情人员的范围，降低内幕信息传播的可能性，但仍不排除有机构或个人利用本次交易的内幕信息进行交易的行为，存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能。

(二)本次交易的批准风险

本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。本次交易能否获得公司股东大会的批准存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

(三)交易对价资金筹措风险

对于本次重大资产购买涉及的对价，上市公司的资金来源为自有资金及自筹资金。因为本次交易涉及金额较大，若贷款金融机构无法及时、足额为公司提供信贷支持且公司无法通过其他渠道筹集到相关款项，则本次交易存在因交易支付款项不能及时、足额到位的融资风险。

(四)溢价间接收购北京豪威少数股权的风险

本次交易的标的公司芯能投资、芯力投资系上市公司通过云交所竞买取得，交易对方瑞滇投资在进场挂牌前履行了审计、评估及国有资产评估备案程序，上市公司最终摘牌交易价格为挂牌底价，合计 168,741.925 万元。芯能投资、芯力投资为专门投资北京豪威设立的投资实体，合计持有北京豪威 10.5464%的股权，因此本次交易实质为收购北京豪威少数股权。

上市公司聘请的立信会计师、立信评估分别对标的资产进行了审计、评估。经评估，截至评估基准日 2018 年 7 月 31 日，芯能投资股东全部权益评估值为 89,130.52 万元，芯力投资股东全部权益评估值为 59,900.12 万元，合计 149,030.64 万元。本次交易摘牌价格虽然为产权交易所的挂牌底价，但较评估值溢价 13.23%，提请投资者关注本次交易作价高于评估值的风险。

(五)法律和政策风险

本公司为中国注册成立的 A 股上市公司，本次交易最终标的北京豪威的主要经营主体为美国豪威，美国豪威系在美国注册独立法人实体。公司不能排除相关政府和监管机构针对本次交易出台政策、法律或展开调查行动，从而延迟本次交易的交割或导致本次交易终止的风险。根据交易双方《产权交易合同》的约定，如果境外审查机构强制要求对本项交易进行审查，则各方同意无条件配合境外审查机构对本项交易的审查，包括但不限于提供相关资料，签署必要的文件等。如因境外审查机构的审查导致本项交易最终无法完成，则上市公司有权单方解除本协议；如境外审查机构对本项交易提出整改要求，则各方同意以不损害上市公司利益为原则共同商讨解决方案，并按照境外审查机构的要求进行整改。如因上述情形导致上市公司遭受损失的，各交易对方应当尽力配合商讨解决方案，并保障上市公司的利益不受损害。

二、标的资产经营风险

芯能投资、芯力投资是专门为投资北京豪威设立的实体。以下涉及标的公司资产经营风险的描述均针对北京豪威。

(一)宏观经济波动风险

半导体产品应用领域非常广泛，涵盖通讯、安防、汽车电子、医疗、家电、工业控制、航空航天、军事等国民经济的各方面，因此半导体产业不可避免地受到宏观经济波动的影响。宏观经济的变化将直接影响半导体下游产业的供求平衡，进而影响到整个半导体产业自身。

总体来说，全球半导体产业的市场状况基本与世界经济发展形势保持一致。未来，如果宏观经济出现较大波动，将影响到半导体行业的整体发展，包括北京豪威从事的半导体芯片设计业务。

(二)行业周期性风险

半导体行业是周期性行业，其增速与全球 GDP 增速的相关度很高。由于半导体产品受到技术升级、市场格局、应用领域等因素影响，整个半导体行业具有周期性波动的特点。半导体周期通常也称为“硅周期”，指半导体产业在 5 年左右的时间内会历经从衰落到昌盛的一个周期。近年来，随着半导体产品研发周期的不断缩短和技术革新的不断加快，新技术、新工艺在半导体产品中的应用更加迅速，进而导致半导体产品的生命周期不断缩短。从国内来看，我国集成电路产业发展有国家产业政策的支持及巨大内需市场的依托，但智能手机、平板电脑，以及诸多移动产品市场趋向成熟，增长趋缓，价格竞争日趋激烈，新一代虚拟现实、无人驾驶、工业机器人等尚在孕育中，北京豪威业务能否继续保持国内市场的较高速度增长存在不确定性，经营业绩可能会因半导体行业周期性而产生较大的波动。

(三)市场变化风险

北京豪威的主营业务为 CMOS 图像传感器的研发和销售，主要产品广泛应用于消费电子和工业应用领域，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、网络摄像头、安全监控设备、数码相机、汽车和医疗成像等。

报告期内，北京豪威在移动通信领域的产品销售占比均较大，若该领域的细分市场出现较大不利变化，北京豪威经营业绩将受到重大不利影响。同时，若在未来业务发展中，如果北京豪威未能把握行业发展的最新动态，在下游市场发展趋势上出现重大误判，未能在快速成长的应用领域推出适合下游用户需求的产品和服务，将会对北京豪威的经营业绩造成重大不利影响。

(四)外协加工风险

北京豪威采用 Fabless 运营模式，专注于集成电路芯片的设计、研发，在生产制造、封装及测试等环节采用专业的第三方企业代工模式。该模式于近十多年来全球集成电路芯片产业中逐渐得到越来越多厂商的运用，符合集成电路产业垂直分工的特点。虽然无晶圆厂运营模式降低了企业的生产成本，使集成电路设计企业能以轻资产的模式实现大额的销售收入，但同时也带来在产品外协加工环节中由供应商供货产生的不确定性。目前对于集成电路设计企业而言，晶圆是产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术及资金规模的要求极高，不同类型的集成电路芯片产品在选择合适的晶圆代工厂时范围有限，导致晶圆代工厂的产能较为集中。

在行业生产旺季来临时，晶圆厂和封测厂的产能能否保障北京豪威的采购需求存在不确定性。同时随着行业中晶圆厂和封测厂在不同产品中产能的切换以及产线的升级，或带来的北京豪威采购单价的变动，若外协加工服务的采购单价上升，会对北京豪威的毛利造成不利影响。此外，突发的自然灾害等破坏性事件时，也会影响晶圆厂和封测厂向北京豪威的正常供货。

虽然北京豪威向多家晶圆厂以及封测厂采购晶圆及封装、测试服务，且报告期内供应关系稳定，但上述因素可能给北京豪威晶圆厂、封测厂的供应稳定性造成一定影响。因此，北京豪威面临一定程度的原材料供应及外协加工稳定性的风险。

(五)技术不能持续创新风险

豪威科技自设立以来专注于集成电路设计业务，经过多年技术积累，已发展为全球领先的 CMOS 图像传感器设计企业，豪威科技掌握了设计高性能 COMS 图像传感器的核心技术。持续开发新产品是豪威科技在市场中保持竞争优势的重要手段，随着市场竞争的不断加剧，半导体产品生命周期的缩短，如豪威科技不能及时准确的把握市场需求和技术发展趋势，将导致豪威科技新产品不能获得市场认可，对其市场竞争力产生不利影响。

(六)税收优惠政策变化的风险

北京豪威子公司豪威半导体、豪威科技（上海）均取得《高新技术企业证书》，减按 15%的税率计算缴纳企业所得税。

如果未来不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，上述公司将不再享受相关的税收优惠，将对北京豪威经营业绩产生一定影响。

(七)汇率波动风险

北京豪威的主要经营实体为美国豪威及下属企业，美国豪威日常经营活动以美元为结算货币，北京豪威合并财务报表的记账本位币为美元。随着人民币日趋国际化、市场化，人民币汇率波动幅度增大，人民币对美元等货币的汇率变化将导致公司合并财务报表的外币折算风险。

(八)海外业务运营风险

美国豪威的产品研发、销售分布在北美、亚洲、欧洲等国家和地区，如相关国家和地区发生突发政治动荡、战争、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、税收增加和优惠减少、贸易限制和经济制裁、国际诉讼和仲裁等情况，都可能影响美国豪威业务的正常运营，进而影响重组后上市公司的财务状况和盈利能力。

(九)业绩增长可持续性具有不确定性的风险

标的业务的增长，即受北京豪威产品技术先进性、经营管理能力、营销力量等因素的影响，又受市场需求变动、市场竞争情况、国际贸易环境、原材料和外协厂商价格波动等因素的影响。北京豪威管理层将按经营规划努力实现较好的业绩，但由于影响因素较多，并且很多因素变动的不确定性较高，因此标的业绩增长的可持续性具有一定的不确定性。

(十)核心人员变动风险

经过多年的发展和积累，北京豪威建立了经验丰富、业务娴熟、具备较高素质的核心经营管理团队和技术团队，核心人员的稳定对本次交易完成后北京豪威的正常、稳定经营有积极的正面影响。

本次交易完成后，上市公司将采取合理的激励措施，促进核心团队和核心人员的稳定。但若核心人员出现大量流失，则可能对北京豪威长期稳定经营及经营业绩产生不利影响。

三、与上市公司相关的风险

(一)债务融资方式用于支付对价提高上市公司财务费用的风险

本次交易中上市公司需要向交易对方支付 168,741.925 万元现金以购买交易对方所持有的芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权。上市公司可以通过多种途径筹集资金以满足上述现金对价支付需求，包括但不限于自有资金、银行贷款等其他融资方式。鉴于上市公司自有资金额度有限，且需要通过较大金额的债务融资以满足上述现金对价支付需求，则在未来一定时期内上市公司的资产负债结构可能发生变化，资产负债率将提升，同时上市公司需要为债务融资承担的财务费用将有所增长，进而可能对上市公司的净利润及每股收益造成影响。提请广大投资者关注债务融资方式用于支付对价提高上市公司财务费用的风险。

(二)控股股东股权质押风险

截至 2018 年 7 月 31 日，虞仁荣持有本公司 279,435,000 股股份，其中已被质押的股份数量为 183,810,205 股，占其持股总数的 65.78%，占公司总股本的 40.33%。受国家政治、经济政策、市场环境、投资者心理因素、公司经营业绩等内外部多种因素的影响，公司股价存在波动，在极端情况下控股股东所质押的股票有被强制平仓的风险，从而可能带来控股股东和实际控制人发生变更的风险。

四、其他风险

(一)股票市场波动风险

股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济周期、利率、资金、供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。由于以上多种不确定因素的存在，公司股票可能会产生脱离其本身价值的波动，从而给投资者带来投资风险。投资者在购买本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。

(二)其他风险

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素给上市公司带来不利影响的可能性，提请广大投资者注意相关风险。

第一节 本次交易概况

一、本次交易的背景

(一)全球集成电路产业并购整合加速

集成电路是信息产业的基础，一直以来占据全球半导体产品超过 80%的销售额，被誉为“工业粮食”，涉及计算机、家用电器、数码电子、自动化、电气、通信、交通、医疗、航空航天等领域，在几乎所有的电子设备中都有使用。对于未来社会的发展方向，包括 5G、人工智能、工业机器人、物联网、自动驾驶等，集成电路都是必不可少的基础，只有在集成电路的支持下，这些应用才可能得以实现。所以，集成电路产业是国民经济中基础性、关键性和战略性的产业，集成电路产业的强弱是国家综合实力强大与否的重要标志。

过去几年，作为衡量行业景气度先行指标的全球半导体设备销售额高速增长。根据国际半导体产业协会（SEMI）的出货报告，2017 年全球半导体制造设备成交金额为 566.2 亿美元，同比增长高达 41%；2018 年预计销售额将继续增长，达到约 630 亿美元。从市场规模来看，根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）的数据，2017 年全球集成电路销售额为 3,431.86 亿美元，同比增长 24%，预计 2018 年销售额增长 9.5%，达到 3,758.99 亿美元。

随着人们对互联网的需求越来越强烈，以及许多国家对智能制造业的强力推进，半导体的需求量也屡创历史新高，推动半导体行业并购交易的风生水起。IC Insights 报告指出，2015 年、2016 年是全球半导体产业并购最活跃的两年，并购交易总值分别达到 1,073 亿美元和 998 亿美元，2017 年下降至 277 亿美元，但仍比 2010-2014 年平均并购交易额的约 126 亿美元高出两倍多。

2015-2017 年，全球半导体产业共有 7 起超过 100 亿美元的顶级规模并购交易。而在半导体产业史上超过 100 亿美元的顶级规模并购交易仅 8 起，分别为安华高（Avago）370 亿美元收购博通（Broadcom）、软银（Softbank）320 亿美元收购 ARM、西部数据（Western Digital）190 亿美元收购闪迪（Sandisk）、黑石集团（Blackstone Group）176 亿美元收购飞思卡尔（Freescale）、英特尔（Intel）167 亿美元收购阿尔特拉（Altera）、英特尔（Intel）153 亿美元收购无比视（Mobileye）、亚德诺（Analog Devices）148 亿美元收购凌力尔特（Linear Technology）、恩智浦（NXP）118 亿美元收购飞思卡尔（Freescale）。

近年来，全球集成电路产业资源加速整合，资源越来越向优势企业集中，这也成为半导体巨头们保持行业地位和迎接未来挑战的利器，后发企业面临的竞争压力越来越大。

(二)国家政策大力支持集成电路产业发展

根据中国半导体行业协会统计，2017 年我国集成电路产业销售额为 5,411.3 亿元，同比增长 24.8%。2015-2017 年，集成电路行业产值的年均复合增长率达 21.5%，其中集成电路设计业在 2016 年首次超过封装测试业，成为销售额最大的部分。但是，伴随着我国集成电路快速发展的却是贸易逆差的不断扩大，2017 年贸易逆差高达 1,933 亿美元，同比增长 16.6%。我国作为目前世界电子消费第一大国，市场规模占全球进一半，但集成电路自给率仅为 10%，特别是高端产品方面，部分产品自给率极低。

我国政府早已认识到发展集成电路的重要性，发布多项支持文件。2011 年，国务院发布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，提出“旨在进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业”。

2014 年，工信部、发改委、科技部、财政部等多部门联合发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确主要任务和发展重点是：着力发展集成电路设计业，加速发展集成电路制造业，提升先进封装测试业发展水平，突破集成电路关键装备和材料。

2018 年，国务院 2018 年政府工作报告提出：要加快制造强国建设，推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展。

(三)国家政策鼓励上市公司兼并重组

2010 年 9 月，国务院出台《关于促进企业兼并重组的意见》（国发[2010]27 号），明确表示通过促进企业兼并重组，加快国有经济结构的战略性调整。

2014 年 3 月 7 日，国务院出台《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发[2014]14 号），明确在企业兼并重组中改善政府的管理和服务，取消限制企业兼并重组和增加企业负担的不合理规定，引导和激励各种所有制企业自主、自愿参与兼并重组。

2014 年 5 月 9 日，国务院出台《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，再次重申“鼓励市场化并购重组，充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用”。

2015 年 8 月 31 日，中国证监会、财政部、国资委、中国银监会等四部委联合发布《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》，通过多种方式进一步深化改革、简政放权，大力推进上市公司并购重组，积极鼓励上市公司现金分红，支持上市公司回购股份，提升资本市场效率和活力。

(四)中国企业跨境并购步伐加快，国家政策进一步放宽

跨境并购作为上市公司增强企业竞争力、提升公司价值的有效方式，成为上市公司全球化运作的主要手段。经过多年的经验摸索和积累，中国部分优质企业已初步具备成功开展跨境投资的实力和条件。

为推动中国资本市场的国际化进程，帮助中国企业适应全球化发展的新形势，政府监管机构近年来相继出台相关规定和措施，进一步放宽中国企业对外投资的审批规定，其中包括发改委、商务部审批备案权限的下放等，支持中国企业进行跨境并购交易。

2014 年 10 月，商务部发布的《境外投资管理办法》大大减少了商务部在境外投资方面相关的行政审批，确立了“备案为主、核准为辅”的新型管理模式，进一步提升了境外投资的便利化，并进一步提升了国内企业进行境外投资与并购的自主权。

2015 年 2 月，国家外汇管理局发布了《关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发[2015]13 号），取消了境外直接投资项下外汇登记核准行政审批，改由银行按照《直接投资外汇业务操作指引》直接审核办理境外直接投资项下外汇登记，负责境外投资外汇管理职能的主管单位由外汇管理局转为银行负责。自 2015 年 6 月 1 日起，外汇管理局不再负责境外投资外汇登记事项，而只是通过银行对直接投资外汇登记实施间接监管，企业可自行选择注册地银行办理直接投资外汇登记。

2018 年 3 月 1 日，国家发改委发布并施行的《企业境外投资管理办法》，取消“项目信息报告制度”，取消地方初审、转报环节，放宽投资主体履行核准、备案手续的最晚时间要求，进一步便利企业境外投资。

二、本次交易的目的

(一)韦尔股份与北京豪威业务高度协同，符合未来发展战略布局

韦尔股份主营半导体设计及分销业务，其中设计业务的主要产品包括分立器件（TVS、MOSFET 等）、电源管理 IC、射频芯片、卫星接收芯片等。分销业务以“战略规划、与设计业务互补”为目标，主要代理及销售数十家国内外著名半导体生产厂商的产品，与设计业务相互补充，以满足终端客户多样化的产品市场需求。北京豪威的主营业务为 CMOS 图像传感器的研发和销售。

目前，韦尔股份与北京豪威的客户均主要集中在移动通信、平板电脑、安防、汽车电子等领域，终端客户重合度较高。本次交易，一方面能够丰富公司设计业务产品类别，带动公司半导体设计整体技术水平快速提升，另一方面也为公司带来移动通信、安防、汽车电子、医疗等领域优质的客户资源。

此外，韦尔股份自身拥有强大的半导体分销体系、完善的销售网络和供应链体系以及高技术、高执行力、高服务能力的现场技术支持工程师（FAE）团队。北京豪威主要从事芯片设计，借助韦尔股份的分销渠道优势，能够快速获取更全面的市场信息，北京豪威可以将精力集中于客户设计方案的理解和芯片产品研发上，进而使得公司整体方案解决能力得到加强，为客户提供更好的解决方案及专业化指导。

本次交易，韦尔股份与北京豪威业务高度协同，符合上市公司未来发展战略布局。未来，韦尔股份将继续立足于半导体设计行业，利用在技术、资质、品牌、销售渠道、服务等方面的优势，以移动通信、数码产品等为发展根基，进一步拓展各类产品在安防、汽车、网通、医疗、智能家居、可穿戴设备等领域的应用，努力成为代表行业领先水平，具有重大影响力的高成长、自主创新的企业。

(二)提升上市公司盈利水平和综合竞争实力

从销售额和市场占有率来看，豪威科技是位列索尼、三星之后的全球第三大图像传感器供应商，技术处于全球领先水平，其 CMOS 图像传感器在中高端智能手机市场占有较高份额，在安防、汽车用图像传感器领域也处于行业领先地位，具有很高的市场接受度和发展潜力。

本次交易完成后，本公司将通过业务整合和分工，充分发挥上市公司与北京豪威的协同效应，上市公司将获得新的业绩增长点，资产质量、业务规模及盈利能力将得到提升，有利于实现股东长远价值的提高。

三、本次交易的具体方案

(一)交易方案概述

2018 年 11 月 28 日，云交所确认韦尔股份为本次挂牌转让资产芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权的受让方。芯能投资、芯力投资均为专门投资北京豪威设立的投资实体，合计持有北京豪威 10.5464%的股权。

本次重大资产购买，上市公司将以现金购买瑞滇投资持有的芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权。

根据瑞滇投资在云交所的挂牌底价，芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权挂牌底价合计 168,741.925 万元，上市公司竞买摘牌及本次交易的成交价格为 168,741.925 万元，具体如下：

交易对方	标的公司	交易价格(万元)
瑞滇投资	芯能投资 100%股权	100,919.189
	芯力投资 100%股权	67,822.736
合计	—	168,741.925

本次交易完成后，韦尔股份将持有芯能投资和芯力投资 100%的股权。

本次交易对价的支付方式为现金。资金来源为自筹资金，包括上市公司自有资金、银行借款或其他合法渠道及方式筹集的资金。

经交易双方同意，本次交易对价在《产权交易合同》所约定的交割的前提条件满足后分两期支付，具体支付安排如下：

支付比例	支付金额(万元)	支付时间及条件
第一期:全部转让款的 30%	50,622.5775	韦尔股份于《产权交易合同》生效之日后 5 个工作日内支付
第二期:全部转让款的 70%	118,119.3475	韦尔股份于《产权交易合同》生效之日起 30 个工作日内付清

根据《产权交易合同》，评估基准日至标的公司股东变更工商登记手续办理完毕期间标的公司的损益由上市公司承担或享有。

(二)本次交易价格较标的资产前期价格的差异及其合理性分析

1、较瑞滇投资受让标的资产价格的差异及合理性

(1)2017 年，瑞滇投资分别取得芯能投资 100%股权和芯力投资 100%股权的交易对价

2017 年 8 月 25 日，芯能投资、芯力投资各自唯一股东中信证券投资有限公司作出股东决定，决定将所持芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权转让给瑞滇投资。

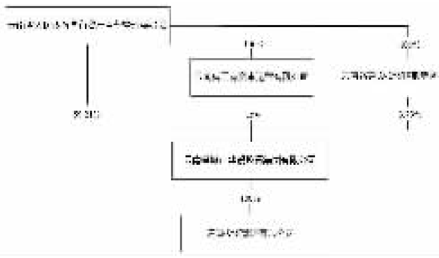
2017 年 9 月 25 日，股权转让相关方签署《股权转让协议》，约定瑞滇投资将芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权分别作价 883,042,906 元、593,448,940 元转让给瑞滇投资，截至 2017 年 11 月 16 日，瑞滇投资已向中信证券投资有限公司支付前述股权转让款合计 1,476,491,846 元。

(2)本次挂牌价与前述价格的差异及合理性

本次芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权成交价为 1,687,419,250 元，较瑞滇投资自中信证券投资有限公司取得标的资产的价格 1,476,491,846 元溢价 210,927,404 元，溢价率 12.50%。

①瑞滇投资国有资产交易履行的有关程序

芯能投资、芯力投资为瑞滇投资全资子公司，瑞滇投资实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会，其股权控制结构图如下：



交易对方瑞滇投资本次挂牌出售芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权系根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会 财政部令第 32 号）的规定进行，主要履行了以下程序：

瑞滇投资股东云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“云南城投”）董事会已作出决议，同意瑞滇投资按照北京豪威科技有限公司（以下简称“北京豪威”）整体估值 160 亿元为价格依据，通过产权交易所公开出让瑞滇投资所持芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权。

瑞滇投资已就其本次转让芯能投资 100%股权委托资产评估机构对芯能投资 100%股权截至 2017 年 12 月 31 日的整体价值进行评估并出具《瑞滇投资管理有限公司拟转让所持有的深圳市芯能投资有限公司 100%股权所涉及的深圳市芯能投资有限公司股东全部权益资产评估报告》，该评估报告已经云南城投备案，备案号为云城投评备[2018]07 号，经评估，芯能投资 2017 年 12 月 31 日的股东全部权益价值为 88,935.05 万元。

瑞滇投资已就其本次转让芯力投资 100%股权委托资产评估机构对芯力投资 100%股权截至 2017 年 12 月 31 日的整体价值进行评估并出具《瑞滇投资管理有限公司拟转让所持有的深圳市芯力投资有限公司 100%股权所涉及的深圳市芯力投资有限公司股东全部权益资产评估报告》，该评估报告已经云南城投备案，备案号为云城投评备[2018]08 号，经评估，芯力投资 2017 年 12 月 31 日的股东全部权益价值为 59,768.77 万元。

2018 年 9 月 18 日，瑞滇投资通过云交所发布股权转让项目预披露公告，披露其将通过云交所挂牌转让其所持芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权，预披露时间为 20 个工作日。

2018 年 10 月 25 日，瑞滇投资通过云交所发布正式披露公告，披露其正式通过云交所挂牌转让其所持芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权，并披露了标的资产转让的相关交易条件，正式披露时间为 20 个工作日。

②上市公司履行的有关程序

2018 年 10 月 25 日，韦尔股份召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于参与竞买深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司各 100%股权的议案》，并于 2018 年 10 月 27 日通过上交所网站等指定媒体发布相关公告，确认瑞滇投资已通过云交所公开挂牌出售其所持芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权，韦尔股份将参与竞买，并说明标的资产在云交所挂牌的相关转让条件，确认本次交易构成重大资产重组并就韦尔股份通过云交所参与竞买标的资产的相关风险进行了提示。

2018 年 11 月 12 日，韦尔股份召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于参与竞买深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司各 100%股权的议案》，并于 2018 年 11 月 13 日通过上交所网站等指定媒体公告了上述决议。

2018 年 11 月 14 日，韦尔股份召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买预案》以及本次交易预案等相关议案，并于 2018 年 11 月 15 日通过上交所网站等指定媒体公告本次交易预案等相关文件。

③价格差异的合理性分析

本次交易的标的公司芯能投资、芯力投资除持有北京豪威 10.5464%股权外无其他对外投资，交易对方在确定挂牌价格过程中，综合考虑了国有资产管理原则以及北京豪威经营情况、同行业估值水平等因素，最终确定挂牌底价；上市公司决定参与竞买，亦基于北京豪威未来发展前景、同行业同类型公司估值水平、与上市公司的协同效应等因素慎重考虑，最终决定在履行决策程序后按照挂牌底价报价参与竞买。

A、北京豪威具有较明显的竞争优势

北京豪威是指经营主体为其子公司美国豪威，美国豪威长期以来致力于 CMOS 图像传感器的研发、生产和销售，在中国及中国香港和中国台湾地区、美国、新加坡、日本、韩国、德国、英国、挪威、印度等国家和地区均设有运营主体，产品销往全球主要国家和地区。2017 年，美国豪威销售的 CMOS 图像传感器超过 80kk，是处于市场领先地位的 CMOS 图像传感器研发、设计企业。

根据权威市场研究机构 Yole Development 的公开报告，美国豪威 2017 年在 CMOS 图像传感器市场占有 11%的市场份额，仅次于日本索尼和韩国三星，是全球最主要的三家 CMOS 图像传感器供应商之一。

美国豪威近三年在 CMOS 图像传感器行业的竞争优势进一步提高。美国豪威及其下属企业全球专利数量从 2016 年末的 3,190 项，增加到 2018 年 7 月末的 3,379 项，核心技术覆盖智能手机、车载摄像头、监控摄像头和医疗设备领域，其中：智能手机是美国豪威产品最主要的应用市场，四相像素（QPD）等新技术的持续研发有助于美国豪威稳固其市场竞争地位；车载摄像头、监控摄像头、医疗设备已逐渐成为 CMOS 图像传感器增长速度最快的应用市场，且美国豪威在上述市场有较强的竞争优势，这些新兴应用市场将成为美国豪威未来业绩的增长点。

2016 年 1 月 28 日私有化以来，美国豪威业务经营持续向好，2016 年、2017 年、2018 年 1-7 月北京豪威扣除私有化及相关费用后（包括扣除 2016 年一次性员工奖励计划、2017 年美国税改、2018 年一次性税务事项等因素的影响）的盈利情况分别为 2,101.35 万元、19,953.41 万元和 20,531.50 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 1-7 月	2017 年	2016 年
净利润	16,641.65	274,531.62	-214,252.93
因收购美国豪威产生的可辨认的无形资产和其他长期资产增值的影响(1)	7,276.99	9,699.87	11,884.57
因收购美国豪威产生的存货影响(2)	—	—	46,837.31
因收购美国豪威所借入并购借款的财务费用的影响(3)	6,025.50	11,523.49	33,004.64
因收购美国豪威所支付的相关中介服务费用的影响(4)	—	—	10,624.30
一次性员工奖励计划的影响(5)	—	—	100,892.48
因收购美国豪威所处置其持有的投资的影响(6)	1,423.29	1,527.76	13,110.99
美国税改及其他一次性税务事项的影响(7)	-10,835.92	-277,329.32	—
调整后净利润	20,531.50	19,953.41	2,101.35

B、北京豪威行业发展趋势向好

根据全球半导体贸易统计组织数据显示，全球集成电路市场规模 2012 年至 2017 年的年复合增长率为 7.58%，其中 2017 年销售额为 3,432 亿美元，同比增加了 24.03%。2015-2017 年，中国集成电路产业年销售额分别为 3,609.8 亿元、4,335.5 亿元和 5,411.3 亿元，同比增速分别为 19.71%、20.10%和 24.81%，增速呈逐年增加趋势，其中半导体设计业销售额为 2,073.5 亿元，增速为 26.10%。

CMOS 图像传感器市场潜力较大，根据 Yole Development 针对 CMOS 图像传感器产业现状进行的调查，2017 年全球 CMOS 图像传感器市场规模为 139 亿美元，而 2021 年市场规模有望达到 188 亿美元，CMOS 图像传感器产业将保持高速增长趋势。

智能手机作为图像传感器目前最主要的应用领域，2017 年全球智能手机总出货量为 14.72 亿部，与 2016 年的 14.73 亿部基本持平。根据 TSR 的统计数据，2018 年三摄手机占比预计为 1%，而到 2022 年将达到 14%。随着双摄像头及三摄像头的普及和推广，消费者对智能手机高倍光学变焦、背景虚化、静态画质提升等图像处理能力提升的需求，以及虹膜识别、面容 ID 等新技术的应用推广，越来越多的手机方案采用双摄或三摄模组，CMOS 图像传感器依然具有较大市场空间。

汽车、安防等领域也是 CMOS 图像传感器的市场的另一个增长点，随着人工智能、面容识别、自动驾驶等新兴技术对图像处理的要求越来越高，汽车及安防设备对摄像头的数量也逐渐增加。

C、同行业可比公司估值水平

北京豪威主营业务属于集成电路设计行业。截至 2018 年 7 月 31 日，与 A 股同行业可比上市公司市盈率和市净率比较情况如下：

序号	证券代码	证券简称	市盈率(TTM)	市净率
1	300373.SZ	扬杰科技	47.49	5.34
2	300613.SZ	富瀚微	61.84	5.74
3	300623.SZ	捷捷微电	42.12	4.71
4	300661.SZ	圣邦股份	88.84	10.46
5	300671.SZ	富满电子	62.26	7.78
6	300672.SZ	国科微	137.13	6.30
7	600171.SH	上海贝岭	45.26	3.36
8	600360.SH	华微电子	50.18	2.38
9	603160.SH	汇顶科技	45.99	9.13
10	603501.SH	韦尔股份	73.39	10.67
11	603986.SH	兆易创新	78.16	17.07
平均数			66.61	7.54
中位数			61.84	6.30
北京豪威			29.34	1.67

注 1：可比上市公司市净率=上市公司市值（2018 年 7 月 31 日）/上市公司净资产（2018 年 9 月 30 日）；

注 2：北京豪威市盈率以北京豪威整体估值 160 亿元以及 2018 年预计净利润为测算基准，市净率以 2018 年 7 月 31 日经审计净资产值为测算基准。

综上，本次交易价格虽较瑞滇投资 2017 年 8 月自中信证券投资有限公司取得标的资产的价格有差异，但与 A 股同行业可比上市公司相比，估值仍处于较低水平，差异合理。交易对方瑞滇投资根据国有资产转让的有关规定履行了有关决策、评估备案、产权交易所挂牌等程序，上市公司亦根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定履行了决策程序并进行了信息披露及风险提示。

2、较原发行股份购买资产预案中标的资产价格的差异及合理性

(1)本次交易对价相对于原发行股份购买资产预案对价增加约 2 亿元的原因及合理性

2018 年 8 月 15 日，公司披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中，芯能投资、芯力投资为公司发行股份购买北京豪威股权方案（以下简称“发行股份购买资产方案”）的交易对方，按照北京豪威 2018 年 5 月 31 日 100%股权预估值 141 亿元测算，芯能投资、芯力投资合计持有的北京豪威 10.5464%股权交易价格为 148,703.82 万元，本次标的资产的挂牌价为 168,741.93 万元，较芯能投资、芯力投资在发行股份购买资产方案中取得的交易价格增加约 2 亿元，除本回复“二、2”的合理性分析之外，发行股份购买资产方案的交易对方尚有通过换股交易取得上市公司股份后的二级市场股票增值预期，因此标的资产的挂牌及成交价格与前次交易对价差异合理。

(2)本次交易作价的变更对前次发行股份购买资产方案的影响

2018 年 11 月 28 日，公司就受让芯能投资 100%股权和芯力投资 100%股权事宜分别与瑞滇投资签署了《产权交易合同》，芯能投资、芯力投资自动退出原发行股份购买资产交易。发行股份购买资产方案将调整减少芯能投资、芯力投资两个交易对象，涉及减少交易对象有关指标、原标的资产相应指标如下：

项目	剔除前原标的资产指标(万元)	剔除对应的指标(万元)	占原标的资产相应指标总量的比例
交易作价	1,499,910.20	148,703.82	9.91%
资产总额	1,367,133.98	148,777.59	10.88%
资产净额	922,890.59	100,948.75	10.94%
营业收入	493,113.11	52,896.71	10.73%

综上，本次调整减少的交易标的对应的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过 20%，按照《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》相关规定，不构成对发行股份购买资产方案的重大调整。

鉴于 2018 年 11 月 28 日公司与瑞滇投资签署了《产权交易合同》构成对前次发行股份购买资产方案的影响，上市公司已于 2018 年 11 月 30 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，对发行股份购买资产方案进行了调整，同时披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及相关中介机构意见等文件。

(三)本次交易的资金来源及自筹资金对公司的影响

本次交易为现金收购，上市公司通过自有资金、自筹资金等方式筹集交易价款并按照交易进度进行支付。

1、本次交易自筹资金具体来源、现金对价的支付计划或安排

2018 年 11 月 23 日，云南产权交易所有限公司（以下简称“云交所”）向公司发出书面《受让资格确认通知书》，告知公司符合受让方资格条件，对公司受让资格予以确认。

2018 年 11 月 28 日，公司就本次竞买芯能投资 100%股权和芯力投资 100%股权向云交所缴纳了保证金。云交所出具《交易结果通知书》，确认芯能投资 100%股权和芯力投资 100%股权的受让方为公司。同日，公司就受让芯能投资 100%股权和芯力投资 100%股权事宜分别与瑞滇投资签署了《产权交易合同》。

公司受让芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权的成交价格为瑞滇投资的挂牌底价，即 168,741.925 万元。公司本次交易所需的资金主要来源如下：

(1)银行并购贷款，预计约 10 亿元。截至目前，公司已取得中国工商银行上海市张江科技支行 10 亿元并购贷款授信额度，招商银行上海分行营业部 10 亿元并购贷款正在招商银行总行审批。

(2)自有资金，预计约 6.8 亿元。自有资金主要来源于公司自身经营利润积累及其他现有流动资金。2018 年 1-9 月，公司剔除 2017 年限制性股票股权激励摊销费用影响后归属于母公司股东的净利润为 4.13 亿元。截至 2018 年 9 月 30 日，公司账面货币资金余额 3.32 亿元，预计公司 2018 年 4 季度经营活动现金净流入可以满足自有资金的需求。

根据公司与瑞滇投资签订的《产权交易合同》，本次交易付款进度安排如下：

付款日期	付款进度
协议生效 5 个工作日内(2018 年 12 月 5 日)	成交价格的 30%
协议生效 30 个工作日内(2019 年 1 月 9 日)	成交价格的 70%

2018 年 11 月 28 日，公司已按照《产权交易合同》的约定，向云交所支付了保证金 253,112,887 元。

2、截至目前，是否已经取得相关金融机构的授信

截至目前，公司已取得中国工商银行上海市张江科技支行 10 亿元并购贷款授信额度，招商银行上海分行营业部 10 亿元并购贷款正在招商银行总行审批。

3、自筹资金对公司财务费用及净利润的具体影响

(1)对资产负债结构的影响

根据 2018 年第三季度报告，截至 2018 年 9 月 30 日，公司短期借款和长期借款余额合计 8.75 亿元，资产负债率为 59.26%，剔除 2017 年限制性股票股权激励影响后的资产负债率为 41.02%。

假设公司 2018 年 1-9 月经营业绩为 2018 年全年经营业绩的四分之三，且公司在 2018 年底前完成对芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权的收购。根据公司 2018 年 10 月 15 日股东大会审议通过的《关于增加公司 2018 年度银行综合授信额度的议案》，2018 年度银行授信额度不超过 26 亿元。据此以借款余额 26 亿元测算，本次交易完成后，公司资产负债率为 67.93%，剔除 2017 年限制性股票股权激励影响的资产负债率为 55.88%。

(2)对财务费用及净利润的影响

根据 2018 第三季度报告财务数据，假设公司 2018 年 1-9 月经营业绩为 2018 年全年经营业绩的四分之三，则剔除 2017 年限制性股票股权激励摊销费用影响后，预计 2018 年全年归属于母公司股东的净利润为 5.51 亿元。需要特别说明的是，上述测算的上市公司 2018 年全年业绩仅为假设，不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。

假设新增并购贷款金额 10 亿元，利率按 8%测算，对财务费用的年化影响金额为 8,000 万元，对净利润的年化影响金额为 7,200 万元，占 2018 年全年净利润假设预测数的比例为 13.07%。

四、本次交易构成重大资产重组

《重组管理办法》第十四条规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

根据上述规定，将本次重大资产购买前 12 个月韦尔股份（含韦尔股份全资子公司）现金购买北京豪威 1.9543%和 1.97%股权与本次交易标的资产合并计算，相关财务比例计算如下：

单位：万元

项目	资产总额	营业收入	资产净额
芯能投资 100%股权	54,431.60	—	54,431.50
芯力投资 100%股权	36,814.30	—	36,814.20
北京豪威 3.9243%股权	54,977.16	35,516.31	54,977.16
上述资产合计	146,223.06	35,516.31	146,222.86
成交金额	223,719.09	—	223,719.09
韦尔股份	282,490.82	240,591.63	117,976.44
财务指标占比	79.20%	14.76%	189.63%

注 1：2018 年 7 月和 8 月，韦尔股份分别收购了北京豪威 1.9543%和 1.97%股权，合计 3.9243%，成交金额合计 54,977.16 万元。

注 2：成交金额=芯能投资、芯力投资 100%股权成交价+北京豪威 3.9243%股权成交价。

根据上表，标的资产成交金额以及 12 个月内连续对同一或者相关资产交易金额占上市公司 2017 年经审计合并资产总额、资产净额的比例超过 50%，因此本次交易构成重大资产重组。

五、本次交易不构成重组上市

本次交易前，虞仁荣持有韦尔股份 279,435,000 股股份，占上市公司总股本的 61.30%，为上市公司控股股东、实际控制人。由于本次交易为现金收购，不涉及发行股份，故本次交易后公司控股股东、实际控制人仍为虞仁荣，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，亦不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

六、本次交易不构成关联交易

根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方与上市公司不存在关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。

七、本次交易对上市公司的影响

(一)对上市公司股权结构的影响

本次交易为现金收购，不涉及股份发行，不会导致上市公司股权结构发生变化。

(二)对上市公司业务的影响

本次交易前，韦尔股份主营半导体设计及分销业务，其中设计业务的主要产品包括分立器件（TVS、MOSFET 等）、电源管理 IC、射频芯片、卫星接收芯片等。分销业务主要代理及销售数十家国内外著名半导体生产厂商的产品，与设计业务相互补充，以满足终端客户多样化的产品市场需求。

本次交易标的公司芯能投资、芯力投资是专为投资北京豪威设立的实体，北京豪威为芯片设计公司，主营业务为 CMOS 图像传感器的研发和销售，韦尔股份与北京豪威的客户均主要集中在移动通信、平板电脑、安防、汽车电子等领域，终端客户重合度较高。通过本次交易，一方面丰富了上市公司设计业务产品类别，带动公司半导体设计整体技术水平快速提升，另一方面也为公司带来智能手机、安防、汽车、医疗等领域优质的客户资源。此外，借助韦尔股份的分销渠道优势，能够快速获取更全面的市场信息，北京豪威可以将精力集中于客户设计方案的理解和芯片产品研发上，进而使得公司整体方案解决能力得到加强，为客户提供更好的解决方案及专业化指导。

因此，本次交易符合上市公司未来发展战略布局。

(三)对上市公司主要财务数据的影响

根据上市公司财务报表与立信会计师出具的《备考审阅报告》(信会师报字[2018]第 ZA15939 号)，本次交易前后，上市公司主要财务数据对比如下：

单位：万元

项目	2018.7.31/2018 年 1-7 月		变动额	变动比率
	实际数据	备考数据		
资产合计	368,462.67	537,204.80	168,742.13	45.80%
负债合计	214,356.72	354,943.81	140,587.09	65.59%
所有者权益合计	154,105.96	182,260.99	28,155.03	18.27%
归属于母公司股东权益合计	153,122.94	181,277.97	28,155.03	18.39%
营业收入	230,787.33	230,787.33	0.00	0.00%
归属于母公司股东的净利润	19,241.33	19,699.29	457.96	2.38%
项目	2017.12.31/2017 年		变动额	变动比率
	实际数据	备考数据		
资产合计	282,490.82	446,958.19	164,467.37	58.22%
负债合计	163,426.73	304,013.63	140,586.90	86.02%
所有者权益合计	119,064.09	142,944.56	23,880.47	20.06%
归属于母公司股东权益合计	117,976.44	141,856.92	23,880.48	20.24%
营业收入	240,591.63	240,591.63	0.00	0.00%
归属于母公司股东的净利润	13,715.63	42,374.84	28,659.21	208.95%

八、本次交易已履行和尚需履行的批准程序

(一)本次交易已履行的批准程序

1、上市公司的决策过程

2018 年 10 月 25 日，韦尔股份第四届董事会第三十一次会议审议通过参与竞买芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权的议案。

2018 年 11 月 12 日，韦尔股份 2018 年第三次临时股东大会审议通过参与竞买芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权的议案。

2018 年 11 月 14 日，韦尔股份第四届董事会第三十二次会议审议通过本次重大资产购买预案等议案。

2018 年 12 月 4 日，韦尔股份第四届董事会第三十四次会议审议通过本次重大资产购买方案等议案。

2、标的公司的决策过程

芯能投资、芯力投资股东瑞滇投资已作出股东决定，同意通过产权交易所公开出让其持有的芯能投资、芯力投资各 100%股权。

3、交易对方的决策过程

瑞滇投资股东云南城投董事会已作出决议，同意瑞滇投资通过产权交易所公开出让所持芯能投资、芯力投资各 100%股权。

(二)本次交易尚需获得的授权、批准和核准

本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：

1、上市公司召开股东大会批准本次交易；

2、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

本次交易能否获得上述相关审批、同意，以及获得审批、同意的时间，均存在不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。

本次交易不属于《重组管理办法》第十三条的情形，不涉及发行股份，无需按照《重组管理办法》第二十九条或第四十四条的规定提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审批。

第二节 备查文件及备查地点

一、备查文件

1、韦尔股份第四届董事会第三十四次会议决议；
2、韦尔股份第四届监事会第二十三次会议决议；
3、交易对方关于本次重组的内部决策文件；
4、韦尔股份独立董事关于本次交易的专项意见；
5、韦尔股份与瑞滇投资签署的《产权交易合同》；
6、芯能投资 2016 年、2017 年和 2018 年 1-7 月审计报告；
7、芯力投资 2016 年、2017 年和 2018 年 1-7 月审计报告；
8、韦尔股份 2017 年和 2018 年 1-7 月备考审阅报告；
9、立信评估出具的资产评估报告；
10、天元律师出具的法律意见书；
11、国信证券、中德证券关于本次交易出具的独立财务顾问报告；
12、其他与本次交易有关的重要文件。

二、备查地点

投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00，于下列地点查阅上述文件：

1、上海韦尔半导体股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区龙东大道 3000 号张江集电港 4 号楼 4 楼
电话：021-50805043
传真：021-50152760
联系人：任冰

2、国信证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区兴盛街 6 号国信证券大厦 7 层
电话：010-88005103
传真：010-66211974
联系人：李勇、姚崟

3、中德证券有限责任公司
联系地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
电话：010-59026666
传真：010-59026970
联系人：胡晓、肖楚男

投资者亦可在中国证监会指定网站上证所网站（http://www.sse.com.cn）查阅本报告书全文。

上海韦尔半导体股份有限公司

2018 年 12 月 4 日